

Mate 2003 第9回

「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム 論文募集について

主催：(社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会
共催：(社)機械学会 電子デバイス／電子実装における信頼性に関する研究分科会
(社)高温学会 加工・再生研究情報委員会
(社)日本塑性加工学会 接合・複合分科会
レーザ加工学会
技術研究組合 超先端電子技術開発機構 (ASE T) 電子SI技術研究所
IMS プロジェクト 環境対応次世代接合技術の開発
大阪大学 先端科学技術共同研究センター

協賛：映像情報メディア学会, エレクトロニクス実装学会、応用物理学会, 化学工学会, 画像電子学会, 軽金属学会, 計測自動制御学会, 高温学会, 高分子学会, 資源・素材学会, システム制御情報学会, 情報処理学会, 人工知能学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電気設備学会, 電子情報通信学会, 日本化学会, 日本機械学会, 日本金属学会, 日本材料学会, 日本シミュレーション学会, 日本接着学会, 日本セラミックス協会, 日本塑性加工学会, 日本電子顕微鏡学会, 日本伝熱学会, 日本非破壊検査協会, 日本表面科学会, 日本品質管理学会, 日本複合材料学会, 日本物理学会, 日本分析化学会, 日本溶接協会, 表面技術協会, プラスチック成形加工学会
(協賛依頼中)

日時：平成15年2月6日(木)～7日(金)
パシフィコ横浜 会議センター
5階(小ホール, 501,502)
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1
TEL:045-221-2121

開催主旨

21世紀はIT革命の時代とも言われ、エレクトロニクス類は高速大容量通信対応に変革していきます。20世紀後半におけるエレクトロニクスデバイス・製品の多様化、高密度化、高機能化の進展はめざましいものがあり、マ

イクロ接合、パッケージング・アセンブリ技術を中心とした生産技術の顕著な革新がありました。今世紀においてもこれら生産技術に対する要求や対象となる材料はますます広がりを見せてきており、ブロードバンドインターネット時代における生産技術の果たす役割は今まで以上に重要となってきました。今後とも先鋭化・多様化する要求に応えていくには、本シンポジウムの対象としているマイクロ接合、パッケージング・アセンブリ技術を中心に、高速大容量対応製品製造のための生産技術の体系化と科学的探求が強く要望されています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

参加費：主催・共催団体加入会社	： 20,000円
協賛学協会会員会社	： 30,000円
論文口頭発表者	： 15,000円
大学・国公立研究機関	： 10,000円
学生	： 5,000円
その他	： 40,000円

講演論文募集

左記主旨に従い、シンポジウムを開催いたします。つきまして、独創性に富むオリジナル講演論文を募集しております。各講演の発表時間は20分(発表12分、質問8分)、発表件数は約90件を予定しております。投稿希望の方は下記の送り先まで、応募していただくようお願い申し上げます。

なお、本シンポジウムで発表されたすべての論文発表者には、別刷り30部を無料贈呈します。また、優秀な論文に対して、シンポジウム賞(論文賞、奨励賞)の表彰制度も用意しております。

応募締切：平成14年9月2日(月) 厳守

応募方法：次の必要事項を記載して、E-mail,FAX,郵送のいずれかでMate 2003事務局に送付して下さい。
E-mail を利用できる方はできるだけE-mailで送付していただけますようお願いいたします。

- (1) 発表題目 (和文と英文)
- (2) 著者名と所属先 (和文と英文)
- (3) 著者代表者の連絡先
- (4) 概要 (和文 120～150 字程度)
- (5) トピックス記号 (カテゴリー A～Cの中から該当する記号を選んで下さい)

例えば、

レーザによる微細加工プロセスに関する研究

=> A-5,B-1

携帯機器創成を目的としたソルダリング部の信頼性の研究 => A-2,B-7,C-6

申込みを受理した後 1 週間以内にE-mailもしくはFAXで受理通知を送付させていただきます。

受理通知が届かない場合は、Mate 2003事務局にご確認して下さい。

また、論文採択につきましては別途、採択通知を 9 月末までに送付いたします。

論文原稿送付締切日：平成14年11月20日 (水)

論文様式概要

本文は日本語で、Figure Caption は英語で記述する。ただし、すべて英語で記述しても結構です。

- 字 体：英語の字体 (フォント) はTimes, 日本語の字体は明朝体とする。
- 題 目：本文が日本語の場合、日本語と英語 (字サイズ：14point, 題目の字体は等幅明朝体またはゴシック体とする)。

●著者名：本文が日本語の場合、日本語と英語 (字サイズ：9 point)。

●Abstract：英語 (60～120 words) (字サイズ：8 or 9 point)。

●本 文：日本語または英語 (字サイズ：9point), 本文二段組。

●マージン：上：25mm, 下左右：20mm。

●用 紙：A4白用紙。

●図の説明：英語 (図面は本文の後ろに並べてもよい)。

●ページ数：4 ページ または 6 ページ (奇数ページでの仕上がりは禁止する)。

なお、論文採択決定後、詳しい投稿規定を送付します。

<論文に関する問合せ先>

大阪大学 接合科学研究所 高橋康夫

Tel. 06-6879-8658 Fa. 06-6879-8689

E-mail : taka@jwri.osaka-u.ac.jp

<論文の送付先、事務に関する問合せ、連絡先>

〒101-0025 東京都千代区神田佐久間町1-11

(株) 溶接学会 Mate 2003 事務局

Mate 2003 担当連絡先

TEL : 06-6879-8698 FAX : 06-6878-3110

E-mail : mate@jwri.osaka-u.ac.jp

<シンポジウム URL >

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2003.html>

トピックス記号

カテゴリー A 工 法	カテゴリー B 研究・開発の観点	カテゴリー C 対象形態・製品
A-1 マイクロ接合 ワイヤボンディング フリップチップ COB, TAB その他	B-1 プロセス B-2 材料 B-3 機能特性 B-4 メカニズム B-5 拡散現象 B-6 界面構造 B-7 信頼性 B-8 品質 B-9 シミュレーション	C-1 モジュール C-2 パッケージ C-3 パワーデバイス C-4 エネルギー変換素子 C-5 通信機器 C-6 携帯機器 C-7 コンピュータ C-8 コンピュータ周辺機器 C-9 液晶ディスプレイ C-10 プラズマディスプレイ C-11 ビデオ C-12 自動車用電装品 C-13 エネルギー変換機器 C-14 その他
A-2 マイクロソルダリング	B-10 設計	
A-3 薄膜形成	B-11 設備・機器	
A-4 厚膜形成 (めっきなど)	B-12 解析	
A-5 ビーム加工	B-13 システム	
A-6 エッチング	B-14 計測	
A-7 マイクロ加工	B-15 環境調和・リサイクル	
A-8 塑性加工	B-16 その他	
A-9 接着		
A-10 光・電子アセンブリ		
A-11 光インターコネクション		
A-12 その他		